

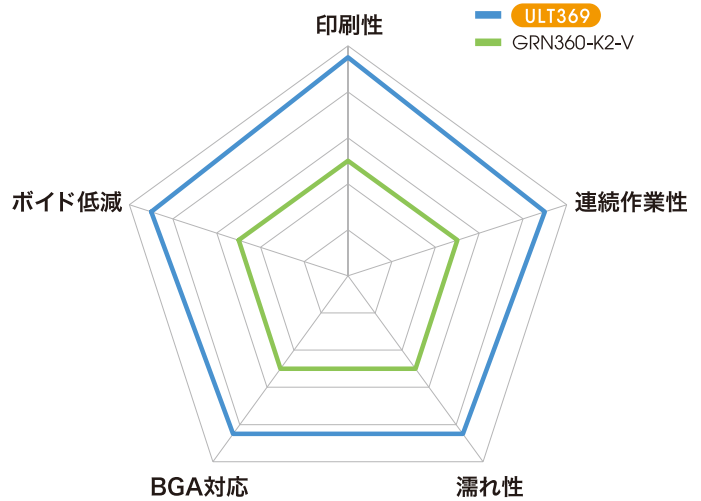
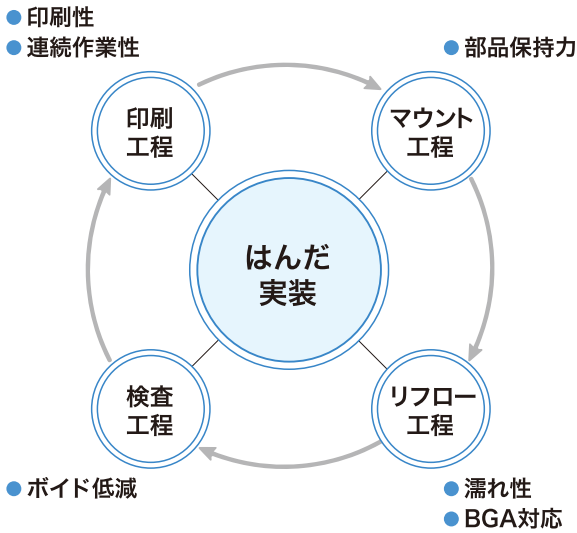
SMT工程を見直した新しい標準品

特長

- 連続作業性を向上させ、ソルダペーストの廃棄量を削減
- BGA未融合とNon-Wet Open (NWO)を抑制
- はんだ溶融時のフラックスの流動性を上げ、ボイドを大幅に抑制

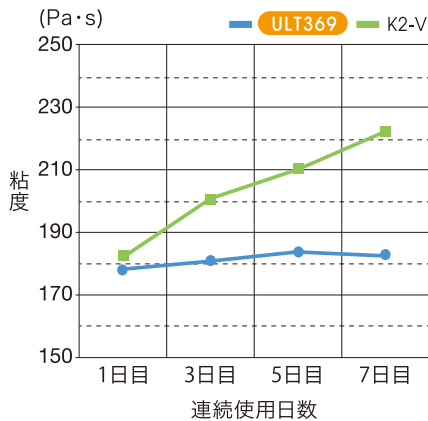


Revolutionary Products



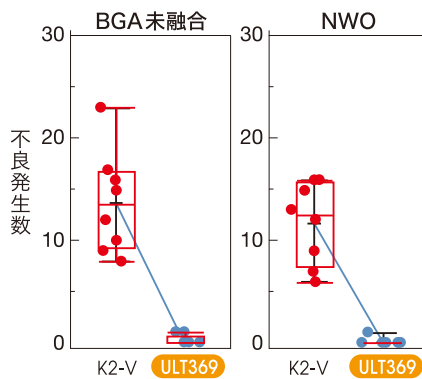
● 連続作業性の向上

印刷工程中に起きる、はんだ粉末とフラックスの反応を抑制。ステンシルライフが向上し、ソルダペーストの廃棄量を削減。



● BGA未融合とNWOを抑制

はんだとパッド間の反応を見直し、かつフラックス耐熱性を向上させることで、BGA未融合とNWOの抑制を実現。



● ボイドの低減

はんだ溶融直後のフラックスの流動性を上げることで、大幅にボイドを削減。

